

证券代码：300661

证券简称：圣邦股份

公告编号：2021-031

# 圣邦微电子（北京）股份有限公司

## 2020 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：未变更

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 156,452,447 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	圣邦股份	股票代码	300661
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张勤	赵媛媛	
办公地址	北京市海淀区西三环北路 87 号 13 层 3-1301	北京市海淀区西三环北路 87 号 13 层 3-1301	
传真	010-88825397	010-88825397	
电话	010-88825397	010-88825397	
电子信箱	investors@sg-micro.com	investors@sg-micro.com	

#### 2、报告期主要业务或产品简介

##### （一）公司的经营范围和主营业务

公司是专注于高性能、高品质模拟集成电路研究、开发与销售的高新技术企业。目前拥有 25 大类 1,600 余款在销售产品，涵盖信号链和电源管理两大领域，其中信号链类模拟芯片包括各类运算放大器及比较器、音频功率放大器、视频缓冲器、线

路驱动器、模拟开关、温度传感器、模数转换器（ADC）、数模转换器（DAC）、电平转换芯片、接口电路、电压基准芯片、小逻辑芯片等；电源管理类模拟芯片包括LDO、微处理器电源监控电路、DC/DC降压转换器、DC/DC升压转换器、DC/DC升降压转换器、背光及闪光灯LED驱动器、AMOLED电源芯片、PMU、OVP及负载开关、电池充放电管理芯片、电池保护芯片、马达驱动芯片、MOSFET驱动芯片等。

公司的模拟芯片产品可广泛应用于消费类电子、通讯设备、工业控制、医疗仪器、汽车电子等领域，以及物联网、新能源、智能穿戴、人工智能、智能家居、智能制造、5G通讯等新兴电子产品领域。

报告期内的公司主营业务未发生重大变化。

## （二）公司主要经营模式

### 1. 盈利模式

公司通过设计、代工制造并销售自主知识产权的模拟集成电路产品，满足终端电子产品客户对高性能、高品质模拟集成电路元器件的需求，从而获得收入和利润。公司的产品需要根据市场的需求以及客户的实际应用要求，进行有针对性的定义及设计开发，并按照公司的技术标准委托代工厂商进行生产制造，经过严格的性能测试后，成为合格产品。公司所有产品均为正向自主研发，拥有完全自主知识产权，全部符合REACH SVHC和RoHS2.0绿色环保标准，综合性能品质达到国际同类产品的先进水平，部分关键技术指标达到国际领先。通过为客户提供优质可靠的产品、贴近的支持与服务以及良好的性价比赢得了广大客户的信任与青睐，产品销量持续增长、客户群体不断扩大。

### 2. 生产模式

公司属于无晶圆厂半导体公司，专注于集成电路的研发与销售，生产环节外包给专业厂商，即从晶圆制造厂采购定制的晶圆，交由封装测试厂进行封装测试，从而完成产品生产。公司通过严格的评估和考核程序选择合格的供应商。报告期内，公司的晶圆制造商主要为台积电，封装测试服务供应商主要为长电科技、通富微电和成都宇芯等。

### 3. 销售模式

根据集成电路行业惯例和企业自身特点，公司采用“经销为主、直销为辅”的销售模式。形成这一销售模式的原因有：一是公司终端客户数量较多、分布较广，经销模式有利于提高销售环节的效率；二是经销商自身拥有广泛的客户资源，有利于公司产品的有效推广。报告期内公司销售收入主要来源于经销模式，预计未来几年公司仍将采用“经销为主、直销为辅”的模式进行产品销售。

报告期内的公司主要经营模式未发生重大变化。

## （三）报告期内主要的业绩驱动因素

报告期内，公司经营稳定增长，实现营业收入119,654.68万元，同比增长50.98%；实现净利润28,358.65万元，同比增长62.30%，其中，归属于母公司股东的净利润28,875.23万元，同比增长64.03%。公司业绩稳步快速增长得益于公司持续推出新产品、不断拓展客户和市场需求强劲等几方面因素的驱动。

### 1. 强化核心技术创新能力、产品种类和数量不断增加

公司拥有较强的自主研发能力和创新能力，十余年来持续加大研发投入，使得核心技术创新能力进一步得以强化，在信号链类模拟芯片和电源管理类模拟芯片两大领域积累了一批核心技术，推出了满足市场需求，并具有“多样性、齐套性、细分化”特点的系列产品，部分产品关键技术指标达到国际领先水平。

报告期内，公司在销售产品增加200余款。经验的积累和技术实力的提升，使得公司产品种类和数量不断增加。在既有产品持续活跃的基础上，近几年每年推出200余款新产品，使得公司的活跃产品数量持续累加，为公司业绩成长提供了长期稳健的支撑。经过多年的积累，公司在销售产品品类从2016年末的16大类增加到报告期末的25大类，增加56%，在销售产品数量从2016年末的800余款增加到报告期末的1,600余款，成长逾100%

报告期内，公司推出新产品200余款，保持了以往年度的增量，广泛覆盖到各个产品品类。

### 2. 品牌影响力进一步加强，客户拓展良好，应用领域拓宽

公司产品服务于广泛市场、广泛客户，覆盖了百余个细分市场领域、几千家客户。报告期内，伴随着品牌影响力日益加强，公司在客户群持续扩大的同时，与客户合作的深度和广度也不断拓展；在市场方面，公司充分发挥产品在性能、品质和服务等各方面的竞争优势，在消费类电子、通讯设备、工业控制、医疗仪器、汽车电子等应用领域保持了稳健的发展，细分应用领域不断增加；在拓展既有市场领域的同时，公司也在物联网、新能源、人工智能、5G通讯等新兴应用领域积极布局，研发相关新品，占领市场先机、拓展市场份额。

### 3. 集成电路市场需求强劲、发展前景广阔

2020年，我国集成电路行业在政策和市场的双重驱动下保持了较高的景气度。一方面，5G、物联网、车联网、智能穿戴等诸多电子设备的需求推动了芯片市场的繁荣；另一方面，国产化替代步伐的加速促进了对国产芯片需求的提升。2020年突如其来的新冠疫情对全球经济造成巨大冲击，这也导致抗疫、防疫相关电子设备销量的暴增；疫情全球化使居家办公成为常态，加剧了对居家办公相关电子设备的需求的同时也带动了消费者对其它电子终端产品的消费热情。市场对芯片整体需求旺盛，生产制造环节的产能不足甚至导致了部分芯片的供货紧张，这一态势预计仍将延续一段时间。

## （四）公司所处行业分析

公司所处行业为半导体集成电路行业。按照《国民经济行业分类（2019修改版）》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”（代码：6550），细分行业为模拟集成电路设计行业。

集成电路通常可分为模拟集成电路和数字集成电路两大类。模拟集成电路主要是指由电阻、电容、晶体管等组成的模拟电路集成在一起用来处理连续函数形式模拟信号（如声音、光线、温度等）的集成电路；与之相对应的是数字集成电路，后

者是对离散的数字信号（如用0和1两个逻辑电平来表示的二进制码）进行算术和逻辑运算的集成电路，其基本组成单位为逻辑门电路。电子产品通常需要模拟集成电路和数字集成电路共同协作来完成各项功能。

公司的主营业务为模拟芯片的研发与销售，属于半导体集成电路产业中的集成电路设计行业。集成电路产业经过几十年的发展逐步形成了设计业、制造业、封装测试业三个细分行业。集成电路设计企业由于更接近和了解市场，通过不断创新开发出高附加值的产品，直接推动着电子设备的更新换代；同时，在创新中获取利润，在快速发展的基础上积累资本并作出新投入，为整个集成电路产业的增长注入了新活力，并带动了整个半导体产业的发展。由此，集成电路设计行业成为了集成电路产业的“龙头”。集成电路设计行业具有较稳定的增长能力和较强的抗周期能力。作为上游产业的集成电路制造业（晶圆代工）及封装测试业则在良率、成本、产能和交期等方面对集成电路设计业产生影响。

集成电路自诞生以来，带动了全球半导体产业在20世纪60年代至90年代的迅猛增长，进入21世纪以后随着市场日趋成熟，行业增速逐步放缓，2011年、2012年因受欧债危机、美国量化宽松货币政策、日本地震以及终端电子产品需求下滑等影响，半导体销售增速曾出现小幅下滑。随着2013年以来全球经济的逐步复苏，PC、手机、液晶电视等消费类电子产品需求不断增加，同时在以物联网、可穿戴设备、云计算、大数据、新能源、医疗电子和安防电子等为主的新兴应用领域强劲需求的带动下保持了持续的增长。2018年因存储器价格上涨等因素带动整个半导体产业实现了双位数的增长，2019年，全球固态存储及智能手机、PC需求增长放缓，产品库存高企，导致全球半导体需求市场下滑，同时全球贸易摩擦升温，中美贸易战也对半导体贸易市场造成较大影响，据WSTS统计2019年全球半导体全球销售额为4,123亿美元，与2018年相比下降12%。2020年尽管全球经济受到新冠疫情的严重影响，WSTS统计全球半导体行业受5G普及、汽车行业复苏等因素提振仍将恢复增长，其中以存储及逻辑芯片反弹最为强劲，同时5G的普及带动了半导体和传感器需求的高涨，此外，受新冠疫情影响，宅家潮流导致个人电脑及数据中心相关的投资有所增加，2020年全球芯片销售额将增长6.8%，达到4,403.89亿美元，而2021年全球半导体市场规模预计有望创下历史新高，同比增长10.49%，达到4,882.74亿美元。市场调研机构预测存储芯片在2021年将实现大幅增长，带动整个市场上扬。同时5G终端换机潮带来的大量出货、物联网、人工智能、电动车、新能源、区块链等应用在2021年逐步推广落地等都将提振半导体市场。

半导体集成电路行业作为全球信息产业的基础，在信息化潮流和产业资本的推动下，已逐渐成为衡量一个国家或地区综合竞争力的重要标志和地区经济的晴雨表，受到各国政府的大力支持。半导体产品的广泛应用也推动了信息化、智能化时代的来临。我国集成电路行业在过去的二十年来取得了长足的进步，一是得益于国家政策的大力扶持和倾斜，自2000年以来，我国政府将集成电路产业确定为战略性新兴产业之一，并颁布了一系列政策法规，以大力支持集成电路行业的发展。2000年国务院颁布的《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、2014年国务院颁布的《国家集成电路产业发展推进纲要》、2016年国务院颁布的《“十三五”国家战略新兴产业发展规划》、2016年发改委及工信部出台的《信息产业发展指南》、2017年科技部印发的《国家高新技术产业开发区“十三五”发展规划》等相关政策的出台及国家集成电路产业投资基金的设立和运作有力地推动了我国集成电路产业的发展和壮大。国务院2018年政府工作报告也明确提出：“要加快制造强国建设。推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展”；二是得益于信息技术的进步和企业创新能力的提升，上游晶圆制造业与封装测试业的生产工艺水平的提高，以及设计企业自身研发能力的增强，都为集成电路设计行业从量变到质变的飞跃奠定了坚实的基础；三是得益于集成电路应用领域的拓展和国内市场需求的不间断扩大，人们对智能化、集成化、低能耗及绿色能源的需求不断催生新的电子产品及功能应用，国内集成电路设计企业获得了大量的市场机会；四是中国作为全球电子产业制造基地的地位不断巩固，国内集成电路设计企业凭借本地优势，紧贴市场需求，快速响应，客户认可度及品牌影响力不断提升，进而显现为整个中国集成电路设计行业的蓬勃发展。

我国目前重点培育和发展的战略性新兴产业都需要以集成电路产业作为支撑和基础，这给未来的集成电路设计行业带来很大的发展空间。物联网、人工智能、云计算、新能源、汽车电子、医疗电子、可穿戴设备、5G通讯等新兴领域的发展将为集成电路设计行业带来持续不断的新动力。我国集成电路产业虽起步较晚，但经过近20年的飞速发展，我国集成电路产业从无到有，从弱到强，已经在全球集成电路市场占据举足轻重的地位。据中国海关总署统计显示，2020年我国集成电路进口总额约为3,500.4亿美元，再创历史新高，同比增长14.6%；出口金额达到1,166亿美元，也创下历史新高，同比增长14.8%；进出口逆差进一步扩大，超过了2,300亿美元。这一方面体现了我国集成电路产业在持续扩大，另一方面也反映出我国集成电路的自给率依然不高，尚有较大的发展空间。2020年我国半导体产业保持了增长态势。据中国半导体行业协会（CSIA）统计，2020年中国半导体产业规模持续扩大，实现销售额为8,848亿元，同比增长17%。另据中国半导体行业协会设计分会统计，2020年集成电路设计行业销售总值保持增长，预计将达到3,819亿元，较2019年的3,084.9亿元增长23.8%。预计2021年，以5G为代表的新基建、物联网、人工智能、新能源汽车、芯片国产化替代需求等都将进一步推动我国集成电路产业的发展。

与国际主流集成电路公司几十年的发展相比，我国同行业厂商仍处于成长阶段，与国外大厂依然存在技术差距，尤其是在制造和设计环节所需的高端技术支持存在明显的短板，目前我国集成电路行业中的部分高端市场仍由国外企业占据主导地位，如国际主流的模拟集成电路公司依旧为德州仪器、亚德诺半导体、美信集成产品、意法半导体、英飞凌等美欧公司。此外，集成电路设计行业是典型的技术密集型行业，在电路设计、软件开发等方面对创新型人才的数量和专业水平均有很高要求。经过多年发展，我国已经累积出一批集成电路专业人才，但由于行业发展时间较短、技术水平较低，且人才培养周期较长，和国际顶尖集成电路企业相比，高端技术人才仍然十分紧缺。

总之，我国半导体产业市场规模巨大，国产集成电路的销售额与集成电路进口额相比差距较大，高端设备、技术和人才储备不足，使得我国集成电路自给率低，依然有很大的成长空间。展望未来，半导体集成电路产业在物联网、消费类、工业和汽车等市场保持增长的同时，人工智能、云计算、大数据、新能源、5G通讯等新兴领域也将持续发力，成为推动半导体市场持续增长的重要动力。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	1,196,546,817.33	792,494,891.33	50.98%	572,392,694.37
归属于上市公司股东的净利润	288,752,313.77	176,032,451.57	64.03%	103,694,105.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	263,949,071.23	160,375,353.58	64.58%	91,115,858.54
经营活动产生的现金流量净额	324,130,609.27	144,515,528.33	124.29%	83,674,688.46
基本每股收益（元/股）	1.8645	1.1411	63.39%	0.6743
稀释每股收益（元/股）	1.8193	1.1224	62.09%	0.6699
加权平均净资产收益率	22.73%	18.25%	4.48%	12.84%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	1,866,795,966.79	1,393,471,331.54	33.97%	1,062,305,962.92
归属于上市公司股东的净资产	1,494,332,284.19	1,115,438,995.45	33.97%	876,490,656.82

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	192,854,110.43	272,654,851.96	397,270,663.28	333,767,191.66
归属于上市公司股东的净利润	30,340,456.18	74,220,243.61	102,476,941.48	81,714,672.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,338,608.82	71,503,266.39	101,912,952.84	60,194,243.18
经营活动产生的现金流量净额	-21,073,542.31	74,936,589.18	88,064,644.91	182,202,917.49

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

### 4、股本及股东情况

#### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,956	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,657	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
#北京鸿达永泰投资管理有限	境内非国有法人	20.76%	32,465,409	0	质押	600,000	

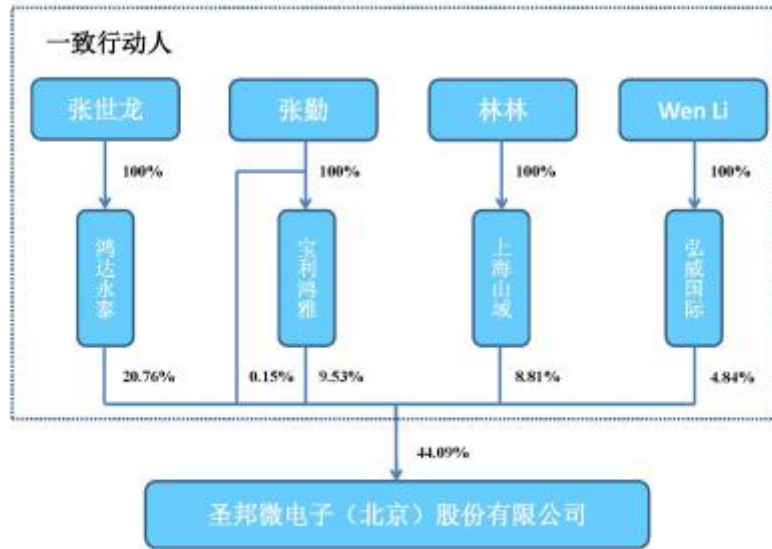
责任公司						
#北京宝利鸿雅投资管理有限责任公司	境内非国有法人	9.53%	14,912,454	0	质押	750,000
上海山域企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	8.81%	13,786,020	0		
中国工商银行股份有限公司—诺安成长混合型证券投资基金	其他	4.96%	7,765,085	0		
弘威国际发展有限公司	境外法人	4.84%	7,571,991	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.51%	5,495,383	0		
中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金	其他	2.33%	3,642,514	0		
全国社保基金四零六组合	其他	2.04%	3,184,767	0		
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.92%	2,998,046	0		
CV VI HOLDING LIMITED	境外法人	1.83%	2,869,056	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、鸿达永泰（张世龙先生 100%持股公司）、宝利鸿雅（张勤女士 100%持股公司）、上海山域（林林先生 100%持股公司）、弘威国际（Wen Li 女士 100%持股公司）、张勤女士、林林先生签署了《一致行动协议》、《一致行动协议之补充协议》，支持和巩固张世龙先生的控制权，宝利鸿雅、上海山域、弘威国际、张勤女士、林林先生于其持有圣邦股份期间，在股东大会行使股东的表决权、向董事会及股东大会行使提案权、行使董事、独立董事及监事候选人提名权等有关经营决策事项时作出与鸿达永泰相同的意思表示，保持一致行动，即不作出与鸿达永泰意思表示相悖或弃权的意思表示，促使并保证所推荐的董事人选在圣邦股份的董事会行使表决权时，与鸿达永泰采取相同的意思表示。</p> <p>2、张世龙先生是公司实际控制人，其与 Wen Li 女士是夫妻关系，与张勤女士是表兄妹关系。</p>					

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年，尽管包括中国在内的全球经济体受到了新冠疫情的极大影响，但是半导体集成电路产业仍然保持了较高的景气度，市场和客户对高性能、高品质模拟芯片的需求依然旺盛，一些品类的集成电路产品甚至出现了供货紧张现象。公司继续秉持“以市场为导向、以创新为驱动”的经营理念，紧密跟踪传统领域及新兴市场的发展趋势，布局并研发了一批与市场需求高度契合的新产品，并加大了对现有产品的市场推广力度。公司的人员在这一年也获得显著增长，特别是研发团队、市场销售团队不断充实壮大，使得公司整体研发实力得到明显提升，产品线得以拓展，产品的技术难度和广度进一步提升。通过全体员工的一致努力，公司在消费类电子、通讯设备、工业控制、医疗仪器和汽车电子等领域积极拓展，协助重点客户进行产品研发。同时，公司产品在物联网、智能家居、可穿戴设备、5G通讯等新兴市场的推广和产品渗透也取得了良好进展，新产品得到客户的认可，并进入批量销售阶段。报告期内，公司营业收入及利润都实现了相对较高的增长。

1. 强化技术创新与核心技术的积累，重视知识产权保护

作为国内高端模拟芯片的领先企业，公司历来高度重视研发投入，源源不断的新产品成为公司持续发展的原动力。报告期内，公司研发费用投入20,707.53万元，较去年同期增加57.70%，占公司营业收入的17.31%；研发人员达到378人，占公司员工总数的66.08%；完成了200余款新产品的研发，涵盖信号链及电源管理两大产品领域、二十余个产品品类。其中，信号链产品包括高精度数模转换器、数字温度传感芯片、低功耗小封装比较器、小逻辑芯片、高压高精度并联参考源、低功耗时序控制芯片、超低失真双路模拟开关、高压小封装运放等；电源管理产品则涵盖3A大电流半导体制冷器控制芯片、I<sup>2</sup>C控制3A及5A降压充电器芯片、单节锂电池保护芯片、高压大电流升压转换器、三路输出大电流高精度AMOLED偏置芯片、LNB天线电源、高压大电流降压转换器、低功耗高精度复位监控芯片、低功耗负载开关、12V步进马达驱动、MOSFET/IGBT驱动等。随着物联网、可穿戴式设备、智能家居、5G通讯等新兴市场及应用的快速发展，各类智能设备对芯片性能的要求也在不断提高。公司根据相关市场需求的变化趋势，基于公司芯片产品在高性能、低功耗、小尺寸、高可靠性等方面的技术积累和优势进行了相关新产品的规划，展开了相应的研发工作，特别是针对TWS蓝牙耳机、传感器信号链、AD/DA数据转换、智能终端AMOLED显示屏供电管理、锂电池保护及充电管理、高效低功耗电源转换、大电流DC/DC电源转换、过压保护、负载开关、马达驱动芯片等产品方向开展研发并推出了一批达到国际先进水平的新一代模拟芯片产品。另外，在制造工艺方

面，随着晶圆代工工厂制成的演进，更多的新产品采用了0.18μm及更小制程的新一代工艺平台，这将有助于进一步降低芯片功耗、减小芯片面积，满足新一代消费类电子产品、物联网、移动智能终端等应用的需求。在封装工艺方面，除了传统的SOT、DFN、QFN等封装工艺外，越来越多的产品采用WLCSP、SC70等小型封装以减小体积、提升性能，更加适用于便携式的智能移动终端产品。

报告期内，公司加强了知识产权相关工作的推进力度并取得明显成效，新申请技术专利160件（其中，发明专利158件，实用新型专利2件），申请数量较2019年同期增长39%。同时，新增国内授权发明专利7件，新增国内授权实用新型专利5件，新增12件集成电路布图设计登记证书，新增国内注册商标2件，新增中国香港注册商标3件，新增境外注册商标8件。公司荣获全球电子技术领域最大媒体集团 AspenCore旗下《电子工程专辑》等媒体联合评选的2020年度“十大中国IC设计公司奖”；公司的高速、高精度、8通道、24位高性能模数转换器在“2020全球电子成就奖”评选中荣获“年度创新产品”奖；公司的高精度Delta-Sigma模数转换器SGM58031荣获2020年第十五届“中国芯”优秀支援抗疫产品奖。

## 2. 传统领域保持继续增长的同时努力开拓新兴市场

报告期内，公司在传统领域继续保持稳定的增长。此外，物联网、智能家居、新能源、人工智能、5G等新应用的涌现也为模拟芯片提供了新的发展机遇。公司紧跟市场发展趋势，在上述新兴领域积极布局、努力开拓。例如智能音箱、TWS蓝牙耳机、手表手环、无人机、无线充电设备等应用中采用了公司多款高性能信号链产品（如高速比较器、高保真音频驱动芯片、运放等）及电源管理芯片（包括锂电池保护及充电管理芯片、马达驱动芯片、LDO等）。同时，公司不断加强市场宣传和拓展力度，通过线上、线下等多种形式进行产品的宣传推广；参加了2020慕尼黑上海电子展、2020深圳国际电子展；通过平面媒体、新媒体、企业微信公众号等方式推广公司的新产品并取得了良好效果。

## 3. 加大人才招聘力度，确保公司持续发展

模拟芯片设计行业存在专业人才短缺、进入门槛高等客观因素，引进和培养优秀的模拟芯片研发、生产管理及市场销售人才是公司人力资源工作的重要内容。报告期内，公司努力克服新冠疫情带来的不利因素，进一步加大了人才引进力度、强化了内部培训、薪酬考评体系等机制，员工数量显著增加。

报告期内，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，继续执行股权激励长青计划，将公司业绩与员工利益紧密联系在一起，共同关注公司的长远发展，充分享受公司发展的成果。用以激发管理团队和核心骨干人员的积极性，增强公司凝聚力，助力公司长效发展。

## 4. 建立健全内部控制，不断完善公司治理

公司严格按照相关法律法规及监管要求，并结合自身发展情况，建立健全公司内部控制制度，不断完善公司治理结构。同时，为加强公司的信息披露工作，保证真实、准确、完整的披露信息，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，公司制定了相关《信息披露管理办法》和《内幕知情人登记备案制度》等，并根据监管要求不断更新修订相关具体内容。董事会、监事会有效的履行相关职责，逐渐规范相关议事规则和工作细则，确保三会工作的顺利开展及完成，完善公司法人治理结构。

模拟集成电路的特点是种类多、应用范围广。公司将继续推进既定的发展战略和经营计划，不断扩大研发团队和投入，在2021年持续推出更多更好的模拟集成电路新品，在5G通讯等新兴应用的带动下，借助国产化替代需求的东风实现下一年度的产值和利润增长目标。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
信号链产品	348,602,744.41	204,339,660.73	58.62%	44.09%	49.31%	2.05%
电源管理产品	847,944,072.92	378,792,842.83	44.67%	54.02%	61.42%	2.05%

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

项目	2020年度	2019年度	增减变动%	说明
营业收入	1,196,546,817.33	792,494,891.33	50.98%	本期较上期增加50.98%系报告期业务增长，收入增加所致。
营业成本	613,414,313.77	420,973,992.27	45.71%	本期较上期增加45.71%，系报告期营业收入增长，相应营业成本增加所致。
归属于母公司股东的净利润	288,752,313.77	176,032,451.57	64.03%	本期较上期增加64.03%，系报告期业务增长，净利润增加所致。

## 6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司自2020年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、质量保证、主要责任人和代理人的区分、附有销售退回条款的销售、额外购买选择权、知识产权许可、回购安排、预收款项、无需退回的初始费的处理等。

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

#### 会计政策变更的内容和原因

#### 受影响的报表项目

#### 影响金额 (2020年1月1日)

因执行新收入准则，本公司将与销售商品及提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债；将应收退货成本从预计负债调整至其他流动资产。	其他流动资产	17,226,530.02
	合同负债	2,983,888.84
	其他流动负债	68,839.83
	预收款项	-3,052,728.67
	预计负债	17,226,530.02

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：

#### 受影响的资产负债表项目

#### 影响金额 2020年12月31日

其他流动资产	21,548,737.15
合同负债	3,020,306.30
其他流动负债	125,104.26
预收款项	-3,145,410.56
预计负债	21,548,737.15



受影响的利润表项目	影响金额 2020年年度
营业收入	--
营业成本	7,758,849.02
销售费用	- 7,758,849.02
所得税费用	--
净利润	--
其中：归属于母公司股东权益	--
少数股东权益	--

**(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。